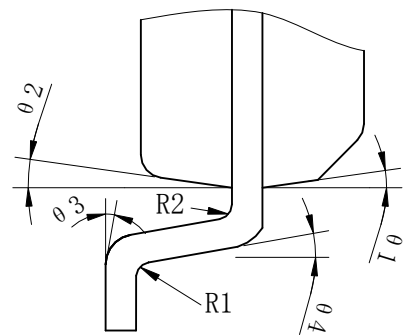
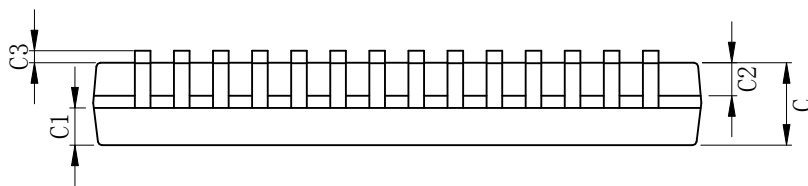
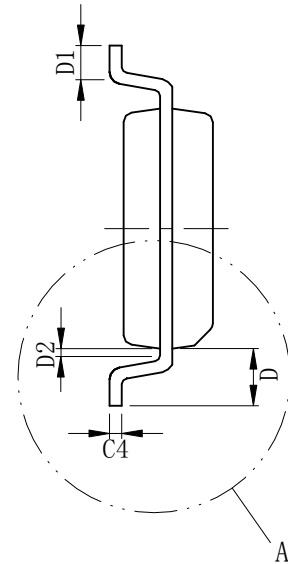
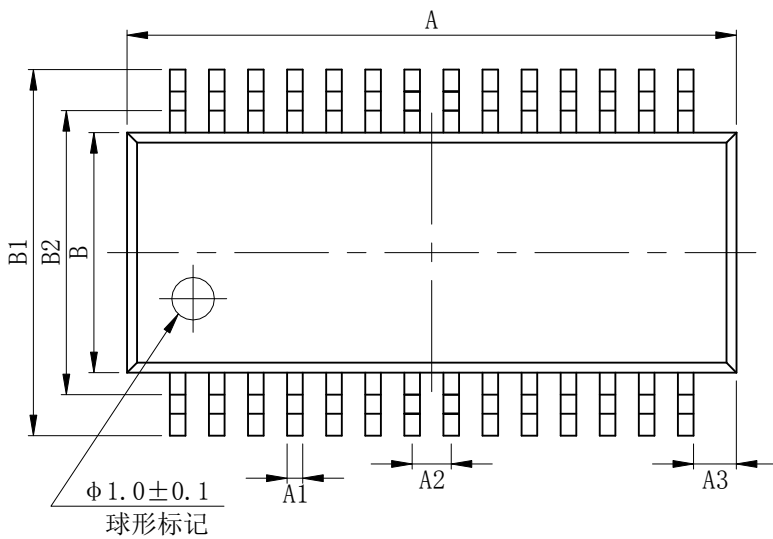




标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)	标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A		9.80	10.00	C4		0.203	0.233
A1		0.254TYP		D		1.05TYP	
A2		0.635TYP		D1		0.40	0.70
A3		0.695TYP		D2		0.15	0.25
B		3.85	3.95	R1		0.20TYP	
B1		5.84	6.24	R2		0.20TYP	
B2		5.00TYP		θ 1		8° ~ 12° TYP4	
C		1.40	1.60	θ 2		8° ~ 12° TYP4	
C1		0.61	0.71	θ 3		0° ~ 8°	
C2		0.54	0.64	θ 4		4° ~ 12°	
C3		0.05	0.25				



DETAIL A

未注尺寸公差
×-----±0.5
×.×-----±0.1
×.××-----±0.01
×.×××-----±0.005

制图	周维	2014.09.03	名称	生效日期		
审核			0.635SSOP28 封装产品图	等级标记	重量	比例
批准						1:1
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-OL-036	气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH.CO.,Ltd		
			版次			